

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

上海晶丰明源半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-16

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（券商策略会）
参与单位名称及人员姓名	国海证券、金鹰基金、东北证券、国泰基金、易方达基金、中银基金、广发基金、兴业基金、淳厚基金、东吴基金、中银国际证券、光大证券资管、兴合基金、兴证资管、兴银基金、德邦证券资管、野村东方、龙航资管、上银基金、东吴基金、泉果基金、相聚资管、华福证券资管、才华资管、西南证券	
时间	2025年9月1日、2025年9月3日	
地点	/	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：杨彪	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司2025年半年度业绩情况</p> <p>2025年半年度，公司实现销售收入7.31亿元，较上年同期减少0.44%；实现归属于上市公司股东的净利润1,576.20万元，较上年同期增加4,626.96万元，同比上升151.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,256.39万元，较上年同期增加3,039.92万元，同比上升170.44%。</p> <p>本报告期公司实现主营产品综合毛利率39.60%，较上年同期提升4.18个百分点。</p> <p>截至2025年6月30日，受报告期内收购控股子公司南京凌鸥创芯电子有限公司剩余少数股东权益及实施利润分配的影响，公司实现归属于上市公司股东的净资产</p>	

11.47亿元，比上年期末减少8.88%。

二、问答环节

1、公司收购易冲的交易预计什么时候能完成？

答：本次重组工作仍在积极推进中，目前处于交易所审核阶段。2025年8月20日，公司披露了《关于上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复》及其他相关公告。

本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于上交所审核通过、中国证监会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和同意注册的时间均存在不确定性。公司会严格按照相关法律法规履行信息披露义务，敬请关注后续公告。

2、2025上半年毛利率同比提升的原因是什么？

答：2025年上半年度，公司主营产品综合毛利率39.60%，较去年同期上升4.18个百分点。一方面，公司积极契合市场需求，通过工艺迭代、加强供应链管理等方式持续降本增效，使得整体毛利率较上年有所增长；另一方面，公司不断优化产品结构，进一步增强在电机控制驱动芯片领域的技术及产品能力，电机控制驱动芯片收入占比进一步提升，收入较上年同期增加24.30%；另外，依托于DrMos产品适应市场需求革新突破，高性能计算电源芯片业务实现快速增长，收入同比上升419.81%。

3、公司经营活动现金流下降较多的原因是什么？

答：2025年上半年度，公司经营活动产生的现金流量净额为9578.56万元，同比下降53.97%，主要系报告期内子公司凌鸥创芯对账期条款为预付的供应商采购需求上升，使得购买商品、接受劳务支付的现金增加；另外受公司持有银行承兑汇票到期时间性差异影响使得托收

金额同比下降；同时人员增加引致支付给职工及为职工支付的现金增加。

4、LED 照明业务收入下降是什么原因？

答：受到通用 LED 市场竞争激烈的影响，公司产品的销量与单价都有明显下滑，上半年整个产品线销售收入较上年同期下降了 15.02%。公司通过扩大智能 LED 照明产品的市场布局，在可控硅调光业务及高性能灯具业务上保持领先地位，同时实现北美 0-10V 调光大功率照明产品、DALI 调光业务的显著增长。另外第六代高压 BCD-700V 工艺平台及独占创新封装 EHSOP12 的逐步量产，叠加供应链整合成效，使得整体产品单位成本下降 14.17%，毛利率提升 4.46 个百分点。

5、公司工艺平台和技术研发的最新进展？

答：报告期内，公司对 BCD-700V 高压工艺平台进行了技术升级，第六代已经开始量产，该工艺可覆盖 LED 照明驱动、AC/DC 电源和部分电机控制驱动芯片产品，进一步巩固了公司在高压工艺技术及产品上的领先优势。

低压工艺平台方面，公司自研的第一代 40V BCD 工艺平台高性能计算电源芯片已大批量稳定量产，基于自研第二代 40V BCD 工艺平台设计的 DrMos 产品性价比显著提升并进入量产。目前公司正在推进第三代工艺的研发，基于该工艺平台的芯片设计已经完成，正在等待生产验证，预计在 2026 年可实现量产。

封装技术方面，公司独占封装 EHSOP12 已进入量产阶段，EMSOP 封装技术也在持续研发中，预计将进一一步带动成本下降。

6、公司电机控制驱动芯片业务进展如何？

答：今年上半年，公司使用自有资金完成了对凌鸥创芯剩余 19.19% 股权的收购，凌鸥创芯成为公司的全资子公司。报告期内，电机控制驱动芯片实现销售收入 1.92

	<p>亿元，较上年同期增长 24.30%。公司通过技术创新持续提升产品集成度和性能，推动业务高速发展。报告期内，汽车电子业务继续实现突破，推出了超高集成度的 ALL-in-One 智能车规级 MCU，空调出风口产品实现销量超百万颗，热管理及座椅通风也都有产品进入量产。</p> <p>7、高性能计算电源芯片产品的业务进展和客户拓展情况如何？</p> <p>答：公司高性能计算产品线的数字多相控制器、DrMos、POL 及 Efuse 全系列产品已经实现量产，进入规模销售阶段，特别是新一代显卡应用，已在多家海外和国内客户开始大批量出货，从而带动整条产品线业务增长；依托于 DrMos 产品适应市场需求革新突破，整体业务得以快速增长，更多国际和国内客户实现业务破局。公司通过持续的 BCD 工艺及产品创新使第二代 DrMos 芯片性能显著提升、成本下降，市场竞争力进一步加强，目前已在多家客户导入并实现量产。</p>
附件清单（如有）	/
日期	2025年9月9日